

SNX 160/RS SYSTEMA (EAGLE)

CARATTERISTICHE

2

Microprocessore	SNX 160/RS 100: Intel PENTIUM 100 a 100/66 MHz SNX 160/RS 133, SNX 160/RS 133 W: PENTIUM 133 a 133/66 MHz
Dual Processor	Possibilità di aggiungere un secondo processore opzionale Pentium, uguale al primario, nello zoccolo ZIF adiacente a quello in cui è inserito il processore primario. In questo caso il sistema diventa dualprocessor
Overdrive Processor	Possibilità di sostituire il processore primario, inserito nello zoccolo ZIF, con futuri Overdrive Processor Intel. In questo caso il sistema rimane monoprocessor
Chip-Set	Intel Neptune
Architettura a doppio bus	32 bit EISA (Extended Industry Standard Architecture) 32 bit PCI (Peripheral Component Interconnect)
Slot espansione	9 slot di cui 6 liberi: 4 EISA, 2 PCI, 1 doppio EISA/PCI, 1 dedicato alla piastra CPU, 1 EISA o PCI per il governo SCSI
Memoria cache	16 KB integrati nel processore + 512 KB di cache 2 ^o livello tipo Parity-Burst, sempre presenti in ogni configurazione
Memoria RAM	16-256 MB con SIMM Parity; 32-256 MB con SIMM ECC.
Cabinet	SNX 160/RS 100 e 133: Box SILVER Narrow (8 bit) SNX 160/RS 133 W: Box SILVER Wide (16 bit)
Governo video integrato su motherboard	Emulazione EGA, CGA ed MDA. VGA standard con risoluzione 640x480, 16 colori, 60/72 Hz. SVGA con risoluzioni: 640x480, 256 colori 60/72 Hz, 800x600, 16 e 256 colori, 56/60/72 Hz, 1024x768, 16 colori, 60/72/87 Hz.
Configurazione sistemi resilience	SNX 160/RS 100 e 133: con governo SCSI RAID DPT Narrow per gli HDU e governo Dagger per le removibili SNX 160/RS 133 W: con governo SCSI RAID DPT Wide per gli HDU e governo Dagger o GO2109 per le removibili La particolare struttura meccanica del cabinet SILVER, associata alla ridondanza degli HDU (RAID-1 e RAID-5), permette la sostituzione di HDU guasti senza spegnere il sistema, (hot-swap), e ricostruzione dei dati sul nuovo HDU, in modo automatico.
Configurazione sistemi non resilience	SNX 160/RS 100 e 133: con governo SCSI Narrow Dagger per HDU e removibili, oppure una Dagger per gli HDU ed una Dagger per le removibili SNX 160/RS 133 W: con governo SCSI Wide Lance GO2109 per HDU e removibili, oppure una GO2109 per gli HDU ed una Dagger o GO2109 per le removibili Il sistema può essere configurato anche con un governo SCSI non RAID, in questo caso la prestazione hot swap sugli HDU non è supportata.
Peripheral Expansion Module PEM RS Narrow PEM RS Wide	É un modulo esterno opzionale che può contenere solo HDU e permette di aumentare la capacità della memoria di massa del sistema. Il PEM è ricavato dal box SILVER Narrow o Wide e può contenere fino a 12 HDU (il doppio del sistema). Il PEM Narrow è previsto che sia collegato solo al governo SCSI RAID DPT Narrow mentre il PEM Wide, solo al governo SCSI RAID DPT Wide. In ogni caso quindi è sempre possibile la sostituzione degli HDU a caldo. Ad un sistema si possono collegare fino a 4 PEM. Il PEM Narrow è disponibile solo per SNX 160/RS 100 e 133.
Uninterruptible Power Supply	Sono disponibili versioni esterne di UPS (con batterie), che permettono al sistema di funzionare in mancanza di tensione di rete AC. Per i sistemi Resilience, dotati di governo SCSI RAID, la presenza dell'UPS è obbligatoria per assicurare l'integrità dei dati sui dischi in caso di mancanza della tensione di rete.

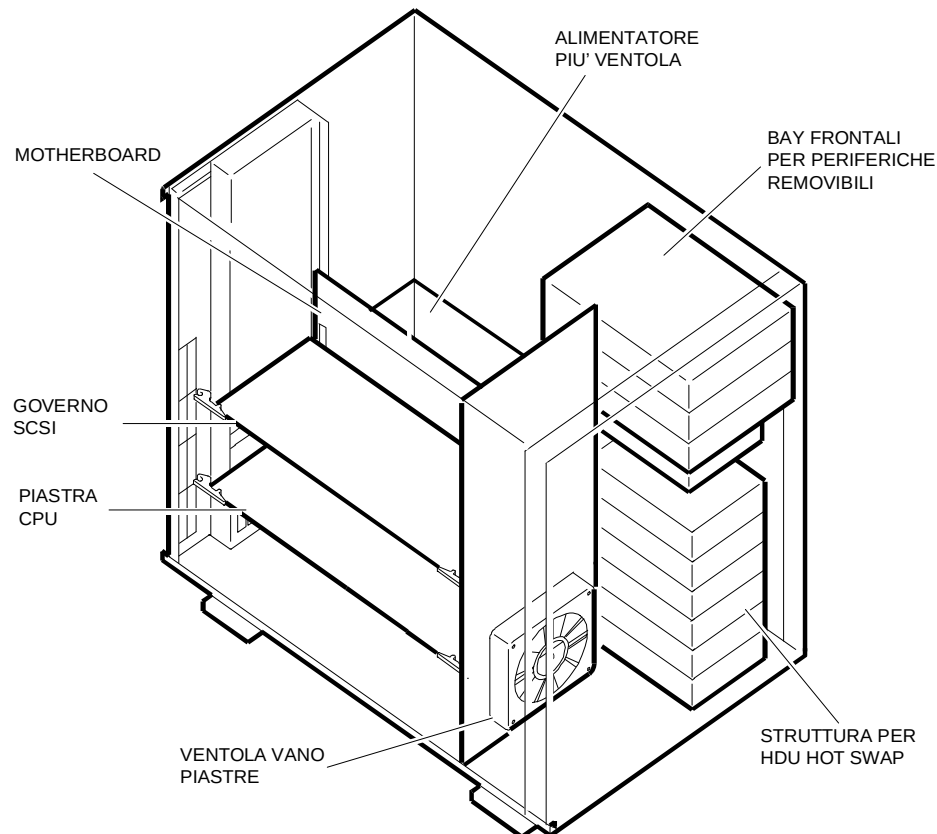
Nota: Il nome commerciale dell'SNX 160/RS Systema rimane invariato sia per la versione a 100 MHz Narrow che a 133 MHz Narrow o Wide. Per comodità quando necessario, nel manuale si differenziano le tre versioni con le denominazioni SNX 160/RS 100, SNX 160/RS 133 ed SNX 160/RS 133 W.

Nota: Mediante il kit opzionale UPG APU 160/133 che contiene la piastra CPU GO2079-133 con un solo processore Pentium 133, è possibile trasformare un SNX 160/RS 100 in un SNX 160/RS 133.

Nota: Non esiste a PdG un kit che permette di trasformare un sistema con cabinet Silver Narrow in un sistema con cabinet Silver Wide. Questa operazione è possibile solo con intervento dell'Assistenza Tecnica e l'operazione consiste in:

- Sostituzione del governo SCSI Narrow Dagger o RAID DPT GO2061 con il governo SCSI Wide Lance o RAID DPT GO2098.
- Sostituzione del Back Plane SCSI Narrow IF2019 con il Back Plane SCSI Wide IF2046.
- Sostituzione del cavo SCSI Narrow (cod. 589377A), a 2 connettori di collegamento tra il governo SCSI ed il Back Plane SCSI Narrow, con il cavo SCSI Wide, (cod. 564166V).

STRUTTURA DEL MODULO BASE DELL'SNX 160/RS



LIVELLI DI AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI SUI PRIMI SNX 160/RS 100

MOTHERBOARD BA2155 liv. 02	PIASTRA CPU GO2063 liv. Nasc	BIOS Rev. 1.08
GOVERNO SCSI RAID DPT GO2061 liv. Nasc FW 6C6	GOVERNO SCSI DAGGER GO624 liv. Nasc	ALIMENTATORE SP300T-3 liv. 01
USER DISKETTE Config. 1.10, Diagn. 1.09	SYSTEM TEST Rel. 1.07	

2

LIVELLI DI AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI SUI PRIMI SNX 160/RS 133

MOTHERBOARD BA2155 liv. 01AG	PIASTRA CPU GO2079 liv. Nasc	BIOS Rev. 2.02
GOVERNO SCSI RAID DPT GO2061 liv. 04 FW 7EE	GOVERNO SCSI DAGGER GO624 liv. 01	ALIMENTATORE SP300T-3 liv. 01
USER DISKETTE Config. 1.13, Diagn. 1.11	SYSTEM TEST Rel. 1.07	

LIVELLI DI AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI SUI PRIMI SNX 160/RS 133 W

MOTHERBOARD BA2155 liv. 05	PIASTRA CPU GO2079 liv. 01	BIOS Rev. 2.03
GOVERNO SCSI RAID DPT GO2098 liv. Nasc FW F74	GOVERNO SCSI DAGGER GO2096 liv. Nasc	GOVERNO SCSI LANCE GO2109 liv. Nasc
ALIMENTATORE SP300T-3 liv. 01	USER DISKETTE Config. 1.13, Diagn. 1.11	SYSTEM TEST Rel. 1.07

Nota: Tutte le evoluzioni dei componenti sono descritte in seguito, nei paragrafi relativi.

SISTEMI OPERATIVI

	Release test. uscita prodotto	Certific. mono	Certific. dualproc.	Software aggiuntivo dualproc.	Note
DOS Windows WfW Windows 95 *	DOS 6.2 Win 3.1 WfW 3.11	Si	Si (su una CPU)	Incluso O.S.	DOS per ambienti single-user, single-task, Windows per ambienti grafici. Non per sistemi resilience
Windows NT Server	3.5	Si	Si	Incluso O.S.	Per gestione reti
Windows NT Server e Service pack 3.0 *	3.51	Si	Si	Incluso O.S.	Per gestione reti
Netware 3.x	3.12	Si	No		Per gestione reti
Netware 4.x	4.1	Si	No		Per gestione reti
UnixWare	2.0.1 2.02c *	Si	Si	Incluso O.S.	Per ambienti multiple-user, multiple-task
SCO Unix SCO Open Server	3.2.4.2 3.0.0	Si	Si	SCO MPX 3.0 + HAS 3.4 + patch OLI002 oppure SCO-UOD 393C *	Per ambienti multiple-user, multiple-task. I pacchetti multiprocessor sono distribuiti da SCO, la patch da Oliservice.
SCO Open Server e Supplement Release 5.0.0d *	R5.0	Si	Si	incluso O.S.	Per ambienti multiple-user, multiple-task. la supplement release 5.0.0d è distribuita da SCO.
Olivetti Unix SVR4.0	V2.4.1	Si	Si	Incluso O.S.	Per ambienti multiple-user, multiple-task
IBM OS/2	2.11 3.0 (Warp) *	Si	No Si Si	FIX PACK98 * Incluso O.S.	Per ambienti single-user, multiple-task

Nota: I sistemi operativi e le release contrassegnate da un asterisco si riferiscono all'SNX 160/RS 133 W.

UNITÀ VIDEO

MODELLO	DESCRIZIONE	FORNITORE	NOME PDG
MDU 1441	Unità video monocrom. flat screen 14" VGA (versione Nord America, Canada e Nord Europa, 110 V). Targhetta DSM 25-314/P-Y	Philips	DSM 25-314/P-Y
MDU 1441/LE	Unità video monocrom., positivo, 14" VGA low emission. Targhetta MDU 1441E/PH01	Philips	DSM 26-314/LE
CDU 1438/GN	Video a colori alta risoluzione 14" VGA, 0,28 dp	Goldstar	DSM 28-142 PS
CDU 1448G	Unità video a colori 14" VGA, multifrequenza low emission, alta risoluzione, 0.28 dp, power saving. Targhetta CDU 1448G/PH	Philips	DSM 28-143/PS
CDU 1460MS	Unità video a colori alta risoluzione, 14" VGA, multifrequenza, ergonomico. Targhetta CDU 1460MS/HY01	Hyundai	DSM 28-144/MS
CDU 1438/SE	Video a colori alta risoluzione 14" VGA, 0,39 dp	Lite-On	DSM 28-039
CDU 1448G/LO	Video colori 14" VGA Plus, SVGA, 0,28 dp, MPR II/PS	Lite-On	DSM 50-148
CDU 1448G/HY	Video colori 14" VGA Plus, SVGA, 0,28 dp, MPR II/PS	Hyundai	DSM 50-149
CDU 1460/MS	Video colori 14" VGA Plus, SVGA, 0,28 dp, MPR II/ PS/DDC1, 64 KHz, Multifunz.	Hyundai	DSM 50-144
CDU 1564/MS	Video colori 15" flat screen VGA Plus, SVGA, 0,28 dp, MPR II/O.S., FTS, Multisync.	Hyundai	DSM 50-151
CDU 1786/D	Video colori 17" flat screen VGA Plus, SVGA, 0,25 dp, MPR II/PS/DDC1, 82 KHz Diamond, Tron Tub.	Mitsubishi	DSM 50-175

Nota: Su questi sistemi è prevista la possibilità di collegare un terminale remoto in sostituzione del video e tastiera. Questa prestazione è gestita dal BIOS ed attivata tramite User Disk. Sui sistemi che montano il governo RAID DPT, la prestazione di terminale remoto non è disponibile. Per questa prestazione consultare l'appendice G.

PERIFERICHE MAGNETICHE

MODELLO PERIFERICA	TIPO	INT.	CAP.	SIZE	NOME PDG
Y-E Data YD-702D-6037D Sony MPF520-3 Mitsumi D359T3 Mitsumi D359T5 Epson SMD 1340 P-031	MFD	SA450	1,44 MB	3,5"	Nella BU
Panasonic JU475-5 C08 Panasonic JU475-5 A08W	MFD	SA450	1,2 MB	5,25" HH	MFD 40-120
Wangtek 5150 ES-ACA	STU	SCSI	150/250 MB	5,25" HH	STS 26-150
Wangtek 5525 ES-ACA	STU	SCSI	320/525 MB	5,25" HH	STS 26-321
Wangtek 51000HT (frontalino standard)	STU	SCSI	1/1,2 GB	5,25" HH	STS 1G-95
Hewlett Packard HP35470A	DAT	SCSI	1,3/2 GB	3,5"	DAT 1300
Hewlett Packard HP35480A	DAT	SCSI	2/8 GB	3,5"	DAT 4000
Hewlett Packard HP C1536A	DAT	SCSI	2/8 GB	3,5"	DAT 4000/S
Hewlett Packard HP C1536A (con adattatore meccanico bay 5,25")	DAT	SCSI	2/8 GB	3,5"	DAT 4000DDS
Hewlett Packard HP C1533A	DAT	SCSI	4/16 GB	3,5"	DAT DDS2-4G
Hewlett Packard HP C1533A(con adattatore meccanico bay 5,25")	DAT	SCSI	4/16 GB	3,5"	DAT 8000DDS2
Panasonic CR-503-B (2X)	CD-ROM	SCSI	650 MB	5,25" HH	CDR TRAY 503
Sony CDU76S (4X) Panasonic CR-504-J (4X)	CD-ROM	SCSI	650 MB	5,25" HH	CDR 4S-500
Panasonic CR-506-B (8X)	CD-ROM	SCSI	650 MB	5,25" HH	CDR 8 S-500
Seagate ST3620NC (conn. SCA)	HDU Narrow	SCSI	525 MB	3,5" x 1"	HDR 525 (solo cabinet Narrow)
Seagate ST31200NC (conn. SCA)	HDU Narrow	SCSI	1,05 GB	3,5" x 1"	HDR 1G (solo cabinet Narrow)
Seagate ST31230WC (conn. SCA) Seagate ST31051WC (conn. SCA)	HDU Wide	SCSI	1,05 GB	3,5" x 1"	HDR 1G
Seagate ST32430WC (conn. SCA) Seagate ST32151WC (conn. SCA) IBM DCAS-32160 (conn. SCA)	HDU Wide	SCSI	2,1 GB	3,5" x 1"	HDR 2G
Seagate ST32550WC (conn. SCA)	HDU Wide	SCSI	2,1 GB	3,5" x 1"	
Seagate ST15230WC (conn. SCA)	HDU Wide	SCSI	4,2 GB	3,5"	HDR 4G

Nota: Gli HDU compatibili per il sistema e per il PEM sono di tipo Hot Swap, sono montati su apposito supporto e sono dotati di connettore di interfaccia ad 80 vie SCA (Single Connector Attachment) per connessione diretta al back plane del sistema e del PEM.

PIASTRE ELETTRONICHE

NOME PIASTRA	DESCRIZIONE	BUS	NOME PDG
BA2155	Piastra base con 9 slot di espansione, governo video super VGA, floppy disk controller, 2 porte seriali, porta parallela, gestione tastiera e mouse	-	Nella BU
GO2063 GO2079-100	Piastra CPU dualprocessor per SNX 160/RS 100, con processore Pentium 100 a 100/66 MHz, inserito in uno zoccolo ZIF, secondo zoccolo ZIF per inserimento del secondo processore opzionale Pentium 100, 8 zocchi per l'inserimento dei SIMM di memoria sistema (minimo 16 MB parity, 32 MB ECC), 256 KB di flash EPROM, 512 KB di memoria cache di secondo livello di tipo Parity - Burst	Dedicated	Nella BU
	Secondo processore opzionale Pentium 100	-	APU SNX160/100
GO2079-133	Piastra CPU dualprocessor per SNX 160/RS 133 e SNX 160/RS 133 W, con processore Pentium 133 a 133/66 MHz, inserito in uno zoccolo ZIF, secondo zoccolo ZIF per inserimento del secondo processore opzionale Pentium 133, 8 zocchi per l'inserimento dei SIMM di memoria sistema (minimo 16 MB parity, 32 MB ECC), 256 KB di flash EPROM, 512 KB di memoria cache di secondo livello di tipo Parity - Burst	Dedicated	Nella BU
	Secondo processore opzionale Pentium 133	-	APU 133 PENT
GO624 (Dagger) GO2096 (Dagger)	Governo SCSI monocanale SCSI-2 Narrow Single-Ended. Il governo è basato sul chip Adaptec AIC7850 (Dagger)	PCI	Nella BU o SCC PCI 101
GO2124 (Dagger)	Governo SCSI monocanale SCSI-2 Narrow Single-Ended. Il governo è basato sul chip Adaptec AIC7850 (Dagger). Sostituisce la GO624/2096	PCI	Nella BU o SCC PCI 101E
GO2109 (Lance)	Governo SCSI monocanale SCSI Wide Single-Ended per SNX 160/RS 133 W. Il governo è basato sul chip Adaptec AIC7870 (Lance)	PCI	Nella BU o SCC PCI 114W
GO2061 (PM3224) (RAID DPT)	Governo SCSI mono/tricanale SCSI-2 Narrow Single Ended, per SNX 160/RS 100 e 133, con prestazioni di RAID-0, 1, 5 per hot-swapping dei dischi. Il secondo ed il terzo canale sono opzionali, tramite aggiunta di un piastrino nei due connettori previsti sul governo. Il governo inoltre contiene 4 zocchi per l'inserimento della memoria cache ECC; 1 zoccolo con 4 MB è sempre presente	PCI	Nella BU o DCR PCI1/3
IF2020 (SX4000/1)	Piastrino piggy back per secondo canale SCSI Narrow (solo esterno), sulla GO2061, cavo SCSI Narrow interno per collegamento piastrino - connettore SCSI a filo carrozzeria, EPROM firmware	-	EXP 2NDSCSI
IF2021 (SX4000/2)	Piastrino piggy back per secondo e terzo canale SCSI Narrow (solo esterni), sulla GO2061, due cavi SCSI Narrow interni per collegamento piastrino - connettori SCSI a filo carrozzeria, EPROM firmware	-	EXP 2&3SCSI
GO2098 (PM3334W) (RAID DPT)	Governo SCSI mono/tricanale SCSI Wide Single Ended, per tutti i sistemi, con prestazioni di RAID-0, 1, 5 per hot-swapping dei dischi. Il secondo ed il terzo canale sono opzionali, tramite aggiunta di un piastrino nel connettore previsto sul governo. Il governo inoltre contiene 4 zocchi per l'inserimento della memoria cache ECC; 1 zoccolo con 4 MB è sempre presente. Questo governo su SNX 160/RS 100 e 133 viene usato solo per il collegamento del PEM Wide	PCI	Nella BU o DCR PCI1/3W

NOME PIASTRA	DESCRIZIONE	BUS	NOME PDG
IF2048 (SX4030/1W)	Piastrino piggy back per secondo canale SCSI Wide (solo esterno), sulla GO2098, cavo SCSI Wide interno per collegamento piastrino - connettore SCSI a filo carrozzeria	-	EXP 2NDSCSIW
IF2049 (SX4030/2W)	Piastrino piggy back per secondo e terzo canale SCSI Wide (solo esterni), sulla GO2098, due cavi SCSI Wide interni per collegamento piastrino - connettori SCSI a filo carrozzeria	-	EXP 2&3SCSIW
MEM 2027 (SM4000/4)	1 SIMM da 4 MB con ECC per espansione memoria cache dei governi GO2061 e GO2098. La massima espansione si ottiene con l'aggiunta di 3 kit, per un totale di 16 MB. Le uniche configurazioni supportate sono 4 MB e 16 MB	-	RACME 04
IF2019	Back plane SCSI Narrow per SNX 160/RS 100 e 133, di collegamento HDU al governo SCSI ed all'alimentazione	-	Nella BU e nel PEM Narrow
IF2046	Back plane SCSI Wide per SNX 160/RS 133 W, di collegamento HDU al governo SCSI ed all'alimentazione	-	Nella BU e nel PEM Wide
IF557	Swap Board per interfaccia LED console sistema	-	Nella BU
IF2022	Jumper Board di unione bus SCSI del Back Plane	-	Nella BU e nel PEM
IF2012	Swap Board per interfaccia LED console del PEM	-	Nel PEM
GO2057 (Stallion)	Piastra multiport 32 canali RS232D. Il kit contiene anche il cavo di connessione al DBOX	EISA	C-MUX8-32E
BOX 800	Box di distribuzione 8 vie RS232D per Stallion (max 4)	-	DBOX 800
BOX 1600	Box di distribuzione 16 vie RS232D per Stallion (Max 2)	-	DBOX 1600
GO530C+IF412C	Governo LAN Ethernet/Cheapernet	AT	NCU 9141-II
GO527+IF412	Governo LAN intelligente Ethernet/Cheapernet	AT	NPU 9145
GO539+IF412C	Governo LAN Ethernet/Cheapernet	EISA	NCU 9180
GO530C+IF411/S	Governo LAN Ethernet 10BT	AT	NCU 9143/S
GO539+IF411/S	Governo LAN Ethernet 10BT	EISA	NCU 9181/S
	Governo LAN Token Ring 16/4 Mbps	AT	NCU9172
	Governo LAN Token Ring	EISA	NCU9183
	Governo LAN intelligente Ethernet 10BT	AT	NPU 9147/S
(fornitore Olicom)	Governo LAN Ethernet/Cheapernet (ex NCU 9141-II)	AT	OC 2121/II
(fornitore Olicom)	Governo LAN Ethernet 10BT (ex NCU 9143/S)	AT	OC 2122/II
(fornitore Olicom)	Governo LAN Ethernet 10B2, 10B5, 10BT	AT	OC 2123/II
(fornitore Olicom)	Governo LAN Ethernet 10B5, 10BT	AT	OC 2125/II
(fornitore Olicom)	Governo LAN Token Ring 16/4 Mbps (ex NCU 9172)	AT	OC 3117
(fornitore Olicom)	Governo LAN Token Ring	EISA	OC 3135
(fornitore Z'NYX)	Governo LAN Ethernet 10B2, 10BT	PCI	ZX312
(fornitore 3Com)	Governo LAN Ethernet 10B2, 10B5	EISA	3C579
(fornitore 3Com)	Governo LAN Ethernet 10B5, 10BT	EISA	3C579-TP
GO573A+IF479	Governo WAN 2V24 intelligente	AT	LPU 2400
GO573A+IF482	Governo WAN X21 intelligente	AT	LPU 2100
GO573	Governo WAN V24 intelligente	AT	LPU 24
GO573A+IF480	Governo WAN V35 intelligente	AT	LPU 3500
GO573A+IF481	Governo WAN V36 intelligente	AT	LPU 3600

ALIMENTATORI ED SPS

ALIM.	TENSIONI USCITA	TOLLERANZA	CORR. MAX	POT. TOT.	TENSIONE INGRESSO	FREQ.	CABINET
SP300T-3	+5,1 V +12 V -12 V -5 V +3,3 V	+5% -4% +5% -4% +10% -10% +5% -5% +5% -4%	32 A 10 A 1 A 1 A 15 A	300 W	100-120 Vac 200-240 Vac	50/60 Hz	Base
PS45	+5 V +12 V -12 V -5 V +5 Aux +3,43 V Fan Out.	+5% -4% +5% -4% +10% -10% +5% -5% +5% -5% +5% -4% -6,4 V / -13,5 V	52 A 11 A 0,5 A 0,2 A 0,6 A 36,4 A 1,6 / 3,6	450 W	100-120 Vac 200-240 Vac	50/60 Hz	PEM

2

Nota: La tensione Fan Output è controllata mediante un sensore che controlla la temperatura dell'aria all'interno dell'alimentatore.

UPS	POT. TOT.	VER.	TENSIONE INGRESSO	TENSIONE USCITA	CAB.
APC - SMART UPS 900 VA	630 W	100/120 Vac	100/120 Vac 50/60 Hz	100/115 Vac 50/60 Hz	Esterno
APC - SMART UPS 1250 VA	900 W				
APC - SMART UPS 2000 VA	1500 W				
APC - SMART UPS 1000 VA (*)	670 W	220/240 Vac	220/240 Vac 50/60 Hz	225/240 Vac 50/60 Hz	
APC - SMART UPS 1400 VA (*)	950 W				
APC - SMART UPS 2200 VA (*)	1600 W				
APC - SMART UPS 3000 VA (*)	2250 W				

(*) = Nuovi modelli della APC che sostituiscono i precedenti.

Nota: Tramite il collegamento dell'interfaccia seriale RS232 tra UPS e sistema ed il supporto del programma software PowerChute plus, specifico per ogni sistema operativo e contenuto su dischetto, è possibile eseguire una impostazione completa delle possibilità hardware dell'UPS. Con questo programma lo stato dell'UPS viene visualizzato sul monitor del sistema e la funzione principale è la possibilità di eseguire la procedura di shutdown programmata nel caso di mancanza di tensione di rete prolungata. Inoltre è possibile eseguire diverse operazioni e funzioni personalizzate.

Nota: Le differenze principali tra i vecchi e i nuovi modelli, oltre che per le potenze diverse sono:
 - Possibilità sui nuovi modelli di poter inserire in un apposito vano una piastra LAN che consente il collegamento in rete dell'UPS.
 - Possibilità per i nuovi modelli di sostituzione delle batterie direttamente dall'operatore, senza togliere l'alimentazione al carico.

Nota: Il modello di UPS viene scelto in base alla potenza richiesta dal sistema che deve essere sostenuto e da eventuali moduli esterni ad esso collegati, ad esempio il PEM.

CAVI DI COLLEGAMENTO SERIALI E PARALLELI

PDG	VAR.	DESCRIZIONE	LUNG. (m)	CONNETTORI
CBL 2934	-	Cavo seriale incrociato per connessione DBOX a stampante	3	RJ45 - Cannon 8 M - 25 M
CBL 2935	-	Cavo seriale diritto per connessione DBOX a modem	3	RJ45 - Cannon 8 M - 25 M
CBL 2938	-	Cavo seriale incrociato per connessione DBOX a WS o stampante	3	RJ45 - Cannon 8 M - 25 F
CBL 5360	-	Cavo seriale incrociato per connessione porta seriale a stampante	3	Cannon - Vaschetta 25 M - 9 F
CBL 5361	-	Cavo seriale diritto per connessione porta seriale a modem	3	Cannon Vaschetta 25 M - 9 F
CBL 5362	-	Cavo seriale incrociato per connessione porta seriale a WS o stampante	3	Cannon Vaschetta 25 M - 9 F
CBL 2491	CAV145	Cavo parallelo per connessione porta parallela a periferica	1,5	Cannon - Centronics 25 M - 36 M
	CAV146		3	
CBL 2858	CAV 143	Cavo seriale diritto, di prolunga, per collegamento modem o stampante. Usato come prolunga di CBL 5360, CBL 2934, CBL 5361 e CBL 2935.	3	Cannon - Cannon 25 F - 25 M
	CAV 144		6	

LIVELLI DI INTERRUPT

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

MAPPA DELLA MEMORIA DEL SISTEMA

2

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

MAPPA DEGLI INDIRIZZI DI I/O

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

CANALI DMA

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

MESSAGGI DEL POWER ON DIAGNOSTIC

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

NOTE DI CONFIGURAZIONE SISTEMA IN PRESENZA DI PIU' GOVERNI SCSI

GOVERNO SCSI GO624/2096/2124 (DAGGER) AGGIUNTIVO

- Il BIOS del sistema è strutturato in modo che la sequenza di scansione al boot venga effettuata prima sugli slot EISA, dallo slot 7 allo slot 3, e poi sugli slot PCI dallo slot 3 allo slot 1 (dal basso verso l'alto). Le regole nel collegamento dell'HDU di boot in presenza di più governi SCSI sono:
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI Dagger (slot 1) e si aggiunge un altro governo Dagger, l'HDU di boot deve essere scollegato dal governo nello slot 1 e collegato al nuovo governo (slot 2 o 3) in quanto prioritari rispetto allo slot 1.
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI RAID DPT o Lance (slot 1) e si aggiunge un governo Dagger (slot 2 o 3), l'HDU di boot rimane collegato al governo nello slot 1 in quanto al governo aggiuntivo Dagger, anche se inserito in uno slot prioritario, vengono collegate solo le periferiche removibili.

Riassumendo, il governo SCSI che gestisce solo periferiche removibili, può essere installato in un qualunque slot, il governo che gestisce l'HDU di boot deve essere installato nello slot prioritario.

GOVERNO SCSI GO2109 (LANCE) AGGIUNTIVO

- Il BIOS del sistema è strutturato in modo che la sequenza di scansione al boot venga effettuata prima sugli slot EISA, dallo slot 7 allo slot 3, e poi sugli slot PCI dallo slot 3 allo slot 1 (dal basso verso l'alto). Le regole nel collegamento dell'HDU di boot in presenza di più governi SCSI sono:
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI RAID DPT o Lance (slot 1) e si aggiunge un governo Lance (slot 2 o 3), l'HDU di boot rimane collegato al governo nello slot 1 in quanto al governo aggiuntivo Lance, anche se inserito in uno slot prioritario, vengono collegate solo le periferiche removibili.

Riassumendo, il governo SCSI che gestisce solo periferiche removibili, può essere installato in un qualunque slot, il governo che gestisce l'HDU di boot deve essere installato nello slot prioritario.

GOVERNO SCSI RAID DPT GO2061 AGGIUNTIVO

- Il BIOS del sistema è strutturato in modo che la sequenza di scansione al boot venga effettuata prima sugli slot EISA, dallo slot 7 allo slot 3, e poi sugli slot PCI dallo slot 3 allo slot 1 (dal basso verso l'alto). Le regole nel collegamento dell'HDU di boot in presenza di più governi SCSI sono:
 - Se nel sistema è già presente il governo PCI Dagger (slot 1) e si aggiunge il governo PCI GO2061 per collegare solo gli HDU, occorre scollegare tutti gli HDU dal governo Dagger e collegarli al governo GO2061 (slot 2 o 3).
Attenzione, con questa operazione si perdono tutti i dati memorizzati sugli HDU spostati in quanto, cambiando il tipo di governo, gli HDU non sono più compatibili per la diversa geometria che il governo assegna loro, ed occorre quindi cancellare gli HDU (vedi utility CLEANHDU, appendice M) e reinstallare il sistema operativo.
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI GO2061 (slot 1) e si aggiunge un secondo governo GO2061, occorre spostare il primo governo dallo slot 1 a quello successivo prioritario, ed inserire il nuovo governo nello slot 1, oppure scollegare tutti gli HDU dal governo nello slot 1 e collegarli al nuovo governo (slot 2 o 3) prioritari rispetto allo slot 1 e configurare il nuovo governo con gli stessi parametri assegnati al primo.

Riassumendo, il governo SCSI che gestisce solo periferiche removibili, può essere installato in un qualunque slot, il governo che gestisce l'HDU di boot deve essere installato nello slot prioritario.

GOVERNO SCSI RAID DPT GO2098 AGGIUNTIVO

- Il BIOS del sistema è strutturato in modo che la sequenza di scansione al boot venga effettuata prima sugli slot EISA, dallo slot 7 allo slot 3, e poi sugli slot PCI dallo slot 3 allo slot 1 (dal basso verso l'alto). Le regole nel collegamento dell'HDU di boot in presenza di più governi SCSI sono:
 - Se nel sistema è già presente il governo PCI Lance (slot 1) e si aggiunge il governo PCI GO2098 per collegare gli HDU, occorre scollegare tutti gli HDU dal governo Lance e collegarli al governo GO2098 (slot 2 o 3).
Attenzione, con questa operazione si perdono tutti i dati memorizzati sugli HDU spostati in quanto, cambiando il tipo di governo, gli HDU non sono più compatibili per la diversa geometria che il governo assegna loro, ed occorre quindi cancellare gli HDU (vedi utility CLEANHDU, appendice M) e reinstallare il sistema operativo.
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI GO2098 (slot 1) e si aggiunge un secondo governo GO2098, occorre spostare il primo governo dallo slot 1 a quello successivo prioritario, ed inserire il nuovo governo nello slot 1, oppure scollegare tutti gli HDU dal governo nello slot 1 e collegarli al nuovo governo (slot 2 o 3) prioritari rispetto allo slot 1 e configurare il nuovo governo con gli stessi parametri assegnati al primo.
 - Se nel sistema è già presente un governo PCI Dagger o GO2061 (slot 1) e si aggiunge un governo GO2098, l'HDU di boot rimane collegato al governo nello slot 1 in quanto al governo GO2098 si può collegare solo il PEM Wide esterno.

Riassumendo, il governo SCSI che gestisce solo periferiche removibili, può essere installato in un qualunque slot, il governo che gestisce l'HDU di boot deve essere installato nello slot prioritario.

UTILITY DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

Per configurare il sistema sono disponibili da tre a cinque programmi a seconda che il sistema sia dotato o meno del governo SCSI RAID ed a seconda del tipo di governo stesso. Il primo programma, Built-in ROM Setup, è residente nella EPROM di BIOS del sistema e quindi attivabile direttamente da tastiera, il secondo, terzo e quarto programma, rispettivamente EISA Configuration Utility (ECU), Configuration Manager (CM) e Storage Manager, sono invece contenuti nello Starter Kit del sistema. Il quinto programma, DPT Configuration utility, è invece contenuto nel firmware del governo RAID DPT e quindi attivabile direttamente da tastiera. Il Built-in ROM Setup è descritto nell'appendice E, lo Storage Manager nell'appendice F, di seguito vengono invece riportate alcune informazioni sulla composizione dello Starter Kit per quanto riguarda il software di configurazione.

DISCHETTI DELLO STARTER KIT

Per i sistemi che non comprendono il governo SCSI RAID DPT, lo Starter Kit è costituito da 6 dischetti da 1,44 MB, 3,5": 3 di User Disk, 1 di driver video e 2 di driver SCSI per Dagger/Lance. Per i sistemi che comprendono il governo SCSI RAID DPT, oltre ai 6 dischetti citati, sono presenti altri 4 dischetti da 1,44 MB, 3,5": 2 contenenti l'utility Storage Manager ed i driver dei sistemi operativi supportati ed altri 2 per la gestione dei sensori di temperatura.

- **User Disk - System Configuration.** Un disco, disponibile solo in versione inglese:
 - Configura automaticamente le piastre EISA e fornisce le informazioni sulla configurazione delle piastre ISA, tramite l'EISA Configuration Utility.
 - Contiene l'utility Plug and Play Configuration Manager che permette di visualizzare la configurazione delle piastre PCI e ISA Plug and Play.
 - Supporta il disco ISA Configuration File Library per fornire informazioni sulle ponticellature delle piastre ISA opzionali più diffuse sul mercato.
 - Supporta il setup del sistema e la personalizzazione del sistema.
 - Supporta il disco Diagnostics nella lingua appropriata.
- **User Disk - Diagnostics.** Il disco Diagnostics permette di scegliere una su cinque lingue. Questo disco permette di eseguire un set di test a basso livello sui moduli hardware presenti nel sistema. Si consiglia al tecnico di assistenza di utilizzare il disco del System Test in quanto permette di eseguire test più estesi.
- **User Disk - ISA Configuration (CFG) File Library.** Comprende i file *.CFG per le diverse piastre di espansione ISA che si possono aggiungere al computer. Poiché contiene solo le directory /US e i file di dati CFG, può essere usato in qualsiasi lingua.
- **Storage Manager.** L'utility è disponibile solo per sistemi con governo SCSI RAID. Verifica la configurazione hardware del governo RAID e dei dispositivi collegati, permette di configurare i Disk Array e permette di eseguire la diagnostica del sottosistema SCSI.
- **SCSI Drivers.** Sono due dischetti che contengono i driver SCSI per il governo Dagger e Lance.
- **EVD Drivers.** Un dischetto che contiene i driver video per DOS e Windows.

- **Driver Resilience Support.** Questi driver, disponibili solo per i sistemi in configurazione resilience, permettono di gestire una segnalazione di temperatura elevata. Sulla Swap Board vengono rilevate, tramite sensori termici, le condizioni di temperatura dell'area piastre e dell'area dischi segnalando all'operatore l'anomalia attraverso il LED della console SYS FAULT. Nel caso il sensore rilevi una condizione di temperatura alta nell'area piastre o nell'area dischi, i driver eseguono le seguenti funzioni:

- Invio dei messaggi di sovratemperatura all'utente
- Memorizzazione della condizione di errore nel file error logging
- Esecuzione automatica dello shutdown del sistema.

Se il sistema è dotato anche di UPS esterno e del software PowerChute plus 4.2 (o successive), oltre allo shutdown, viene spento il sistema evitando così che l'hardware subisca dei danni. I driver Resilience Support sono disponibili per i seguenti S. O.:

- Microsoft Windows NT versione 3.x
- Novell NetWare Versione 3.1x e 4.xx
- SCO Unix 3.2 versione 4.2
- SCO Open Server Network System 3.0.0
- SCO Open Server Enterprise System 3.0.0.

Nota: Il sistema operativo Olivetti UNIX SVR4.0 ver. 2.4.1 ha i driver thermal sensor già integrati.

Nota: Da giugno 96 i dischetti del Resilience Support non sono più contenuti nello Starter Kit perché vengono inseriti nel Server View dalla rel 2.01.

CONFIGURAZIONE DELLE PIASTRE OPZIONALI

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo 1 (SNX 140 / 140/R / 160 / 160E / 160/R Systema).

NOTE DI CONFIGURABILITÀ PIASTRE LINEA INTERFACCIA AT

Le piastre Multiport e le piastre LAN/WAN con interfaccia AT, in genere possono essere mappate nel primo megabyte e nel megabyte F. Il primo megabyte come visto dalla mappa di memoria, è occupato per la maggior parte dalla memoria di sistema e non è possibile installare piastre mappate ad indirizzi già occupati da questa memoria. Sono comunque disponibili due blocchi di memoria rispettivamente da 128 KB (da 80000h a 9FFFFh, da 512 a 640 KB) e 96 KB (da C8000 a DFFFFh, da 800 a 896 KB). In particolare la piastra LAN WAN AT vengono ponticellate per essere mappate nel blocco di 96 KB, (con buffer da 32 KB se ne possono montare 3, con buffer da 16 KB fino a 6), mentre le piastre Multiport AT (non previste su questo sistema), se installate nel primo MB, possono essere mappate solo nel blocco di 128 KB.

Su questo sistema se si installa una piastra Multiport AT nel primo megabyte, viene automaticamente disabilitato il segmento di memoria compreso tra 512 KB e 640 KB (non è possibile disabilitarlo manualmente tramite utility ROM Setup o tramite User Disk). Le piastre AT possono comunque essere mappate anche nel megabyte F. Infatti il chipset del sistema è in grado di aprire degli spazi di memoria nel megabyte F per l'inserimento di memoria esterna.

L'installazione di piastre EISA non richiede invece l'apertura di spazi di memoria del sistema in quanto possono essere mappate oltre la massima memoria installabile nel sistema.

Nota: L'inserimento di piastre AT nello spazio di 128 KB del primo MB limita la memoria di base a 512 KB incompatibilmente con alcuni applicativi e sistemi operativi, esempio SCO, che richiedono 640 KB di memoria di base.

La seguente tabella fornisce alcuni esempi di assegnazione delle risorse del sistema.

TIPO DI PIASTRA	N. MAX	SLOT	IRQ	ES. INDIRIZZI BASE DPM	BUFFER SIZE	FILE CFG	NOTE
Piastra base Tastiera Floppy disk COM1 COM2 LPT1 RTC Mouse PS/2	1	-	1 6 4 3 7 8 12			!OLI0609	
Piastra CPU Timer Coproprocessore	1	CPU	0 13			!OLI12C1	
GO624 GO2096 GO2124 GO2109	3	1÷3	5, 10, 11, 15				Più piastre possono condividere lo stesso IRQ
GO2061 GO2098	3	1÷3	11, 14, 15				Più piastre possono condividere lo stesso IRQ
Multiport EISA STALLION	4	3÷7	3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15,	sotto il 1 ^o MB nel MB F (16 ^o) nel 3 ^o GB	64 KB	!STL0400	Più piastre possono condividere lo stesso IRQ
NPU 9145 NPU 9147S AT Ethernet	4	3÷7	3, 9	da C A000 a F 4000 F4 0000 (MB F) F8 0000	8 KB	!OLIF031 Ver. 1.03 !OLIF061 Ver. 1.03	Più piastre non possono condividere lo stesso IRQ
NCU 9141II NCU 9143/S AT Ethernet	4	3÷7	9, 10, 12, 3, 5, 7, 15	C 0000 (1 ^o MB) C 4000 C 8000 C C000 D 0000 D 4000 D 8000 D C000 F2 0000 (MB F) F4 0000 F6 0000 F8 0000	16/32/64 KB 128 KB	!OLIF012 Ver. 1.01 !OLIF052 Ver. 1.01	Più piastre non possono condividere lo stesso IRQ
OC 2123 AT Ethernet	4	3÷7	3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15	da C 0000 a E C000	8 KB	!ISA1063 Ver. 1.01	Più piastre non possono condividere lo stesso IRQ
NCU 9180 NCU 9181S EISA Ethernet	4	3÷7	9, 10, 11, 15	No DPM		!OLI1031 Ver. 1.04 !OLI1041 Ver. 1.02	Più piastre possono condividere lo stesso IRQ
NCU 9172 AT Token Ring	4	3÷7	9, 10, 11, 3	con eprom RPL: da C 0000 a F E000 oppure Nota	8 KB	!OLIF1C1 Ver. 1.00	Più piastre possono condividere lo stesso IRQ

TIPO DI PIASTRA	N. MAX	SLOT	IRQ	ES. INDIRIZZI BASE DPM	BUFFER SIZE	FILE CFG	NOTE
LPU 24	4	3÷7	2, 3, 5, 10, 11, 12, 15	C 0000 C 4000 C 8000 C C000 D 0000 D 4000 D 8000 D C000 E 0000 E 4000 E 8000 E C000	16/32/64 KB	!OLIF221 Ver. 1.01 !OLIF241 Ver. 1.01 !OLIF231 Ver. 1.01 !OLIF251 Ver. 1.01 !OLIF261 Ver. 1.01	Più piastre possono condividere lo stesso IRQ (non l'IRQ 2)

2

Nota: La piastra AT Token Ring, se non è dotata di EPROM di RPL, può interfacciare il sistema utilizzando i canali DMA 5, 6, 7 oppure le porte di I/O seguenti:

1^a piastra: 0A20-0A23 & 0A30-0A3F

2^a piastra: 0A24-0A27 & 0A40-0A4F

3^a piastra: 0A50-0A53 & 0A60-0A6F

4^a piastra: 0A54-0A57 & 0A70-0A7F

EVOLUZIONE USER DISK

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
05/95	1.10	Introduzione User Disk per SNX 140, 160, 140/R, 160/R, 160E e 160/RS. Configuration Utility rel. 2.07, Plug & Play Configuration Manager 1.21. I livelli compatibili sono: motherboard P2.1 Rev. F o P2.2 Rev A e revisioni successive, CPU GO896 P2.0 Rev A con BIOS 1.09 e successive, CPU GO898 P1.0 Rev F con BIOS 1.06 e successive, CPU GO2063 liv. Nasc con BIOS 1.08 e successive. - La scelta dell'IRQ per Dagger viene fatta attraverso il file SCI, se nel file SCI l'IRQ è errato, l'informazione viene presa dalla NVRAM al POD. Questo nuovo meccanismo di configurazione non può quindi essere usato alla prima installazione del governo. Occorre allora attivare l'utility di configurazione due volte: la prima per memorizzare lo slot della nuova piastra, la seconda per il setup con il file SCI. Logicamente lo slot PCI memorizzato nel file SCI deve coincidere con lo slot fisico in cui la Dagger è installata. - Per evitare problemi durante il POD, si raccomanda di non usare la prestazione LOCK con il governo GO2061.
09/95	1.13	Questa release è compatibile anche per SNX 160/RS 133 MHz ed SNX 140 75 MHz; il livelli compatibili sono: motherboard P2.1 Rev. F o P2.2 Rev A e revisioni successive, CPU GO896 P2.0 Rev A con BIOS 1.09 e successive, CPU GO898 P1.0 Rev F con BIOS 2.00 e successive, CPU GO2063 liv. Nasc con BIOS 2.00 e successive, GO2076 liv Nasc con BIOS 2.00. - Supporto del processore Pentium 133 a 133 MHz (aggiunto file !OLI12C1.CFG). - Supporto del processore Pentium 75 a 75 MHz (aggiunto file !OLI12B1.CFG). - Il file !CFG.NDX su dischetto ISA Configuration File Library è stato aggiornato per risolvere il problema dei lunghi tempi di attesa richiesti durante la creazione dell'indice dei file CFG quando il dischetto è protetto in scrittura. - Aggiornato l'overlay code per il governo Dagger per evitare il messaggio "PCI Configuration Error" al POD, quando tutte le risorse del sistema sono in Lock. - La selezione "Write Through" per la cache di secondo livello è disponibile solo per SNX 140 66 MHz (chipset Mercury). - Aggiornato il file di configurazione della piastra base !OLI0609.CFG per ridurre lo spazio richiesto su NVRAM. Con le versioni precedenti, con il 15° Mega di memoria disabilitato e più di 64 MB di memoria totale, non era possibile salvare la configurazione. - Rimozione dei seguenti file CFG in quanto le relative piastre non sono a PdG: !OLI1011.CFG "Olivetti EISA Video Controller (EVC-1)" !OLI1021.CFG "Olivetti EISA SCSI Controller (ESC-1)" !OLI1023.CFG "Olivetti EISA SCSI Controller (ESC-2P)" !OLI1024.CFG "Olivetti EISA SCSI Controller (ESC-2P/FDU)" !OLI1051.CFG "Olivetti EISA Dual SCSI Controller (EFP2/EFP2E)" !OLIF1A1.CFG "Olivetti Video Controller (OVC)" !OLIF201.CFG "Diagnostic subsystem for remote diagnostics".

EVOLUZIONE USER DIAGNOSTIC

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
02/95	1.09	Introduzione User Diagnostic per SNX 140, 160, 140/R, 160/R, 160E, 160/RS. I livelli compatibili sono: motherboard P2.1 Rev. F o P2.2 Rev A e revisioni successive, CPU P5 P2.0 Rev A con BIOS 1.07 e successive, CPU P54C P1.0 Rev F con BIOS 1.02 e successive. SCSI Library versione 0.26.
12/95	1.11	Questa release è compatibile con motherboard P2.1 Rev. F o P2.2 Rev A e revisioni successive, CPU P5 P2.0 Rev A con BIOS 1.07 e successive, CPU P54C P1.0 Rev F con BIOS 1.02 e successive. - Risolto problema con Report.TXT di HDU_DIA con HDU maggiori di 2 GB. - Aggiunta, nel test STR_DIA, dell'STU Wangtek 51000HT da 1 GB - Risolto problema col test read/write buffer di DAG_DIA - Aggiunta, nel test CDR_DIA, del CD-ROM Sony 76S - Aggiunta, nel test DAT_DIA, dei modelli HP C1534A da 2 GB, HP C1536A da 4 GB, HP C1533A da 8 GB, HP C1533A (autoloader) da 48 GB. Su quest'ultimo drive, il diagnostico non supporta il Media Changer - Risolto problema su cartridge con CDR_DIA - Risolto problema sul subtest Retension di STR_DIA - Link dei test DAG_DIA, ARW_DIA con SCSI Library ver. 0.27 - Link dei test CDR_DIA, STR_DIA, DAT_DIA, HDU_DIA con SCSI Lib. ver. 0.28.

EVOLUZIONE EVD DRIVERS

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
05/95	1.01	Introduzione driver video per DOS e Windows. Il disco è etichettato: SNX 1xx, 1xx/E, 1xx/R, 1xx/RS (cirrus 5422) EVD Disk for DOS & Windows codice 2691034 Q.

EVOLUZIONE SCSI DRIVERS

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
05/95	1.1	Introduzione driver SCSI. I dischetti sono: - SNX xxx/RS - SCSI Drivers EZ SCSI - NetWare - OS/2 Disk. #1 cod. 2691025 K - SNX xxx/RS - SCSI Drivers UnixWare 2.0x - SCO Diskette #2 cod. 2691026 X

EVOLUZIONE DRIVER RESILIENCE SUPPORT

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
05/95	1.0	Introduzione driver Resilience Support. I dischi sono: - SNX 1xx, /E, /R, /RS Resilience Support disk 1/2 codice 2691032 X - SNX 1xx, /E, /R, /RS Resilience Support disk 2/2 codice 2691033 T.
07/95	2.01	Nuova release per compatibilità con l'installazione di Server View. È necessario che questa release di driver sia abbinata alla release 2.00 o successive di Storage Manager. I dischi sono: - Resilience Support disk 1/2 codice 2691121 B - Resilience Support disk 2/2 codice 2691122 P.
11/95	2.1	Nuova release per supporto Server View 1.1. I dischi sono: - Resilience Support disk 1/2 codice 2691249 H - Resilience Support disk 2/2 codice 2691250 F.

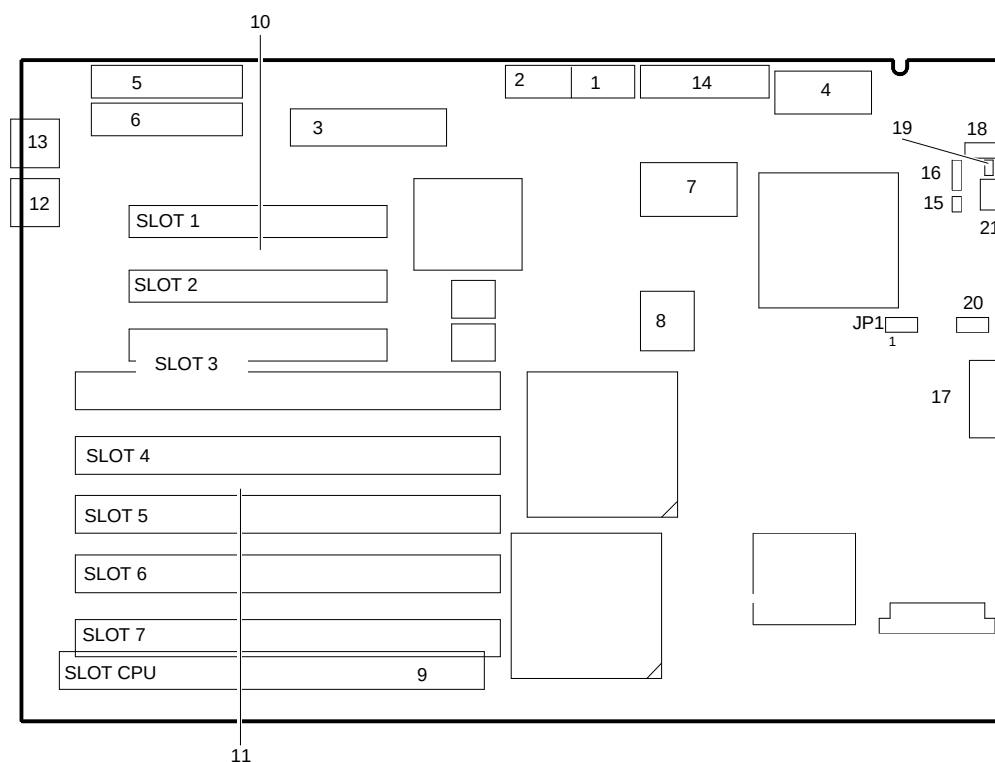
EVOLUZIONE SERVER VIEW

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA
10/95	1.0	Introduzione software Server View. Starter Kit Server View codice 2754560 H.
11/95	1.1	Nuova release per risoluzione di alcune anomalie della release 1.0, supporto di SCO Open Server 5.0 e supporto UnixWare. Starter Kit Server View codice 2757950 D-01.
5/96	2.01	Nuova release di Server View che contiene anche i driver Resilience Support che pertanto non saranno più disponibili come dischetti nello Starter Kit. La nuova release di Server View ha codice 211996 L ed è distribuita su CD-ROM.

EVOLUZIONE SYSTEM TEST

DATA	REL.	MOTIVO MODIFICA	CODICE
02/95	1.07	Introduzione System Test per SNX 140, 160, 140/R, 160/R, 160E, 160/RS. I livelli compatibili sono: motherboard P2.1 Rev. F o P2.2 Rev A e successive, CPU GO896 P2.0 Rev A con BIOS 1.07 e successive, CPU GO898 P1.0 Rev F con BIOS 1.02 e successive, CPU GO2063 liv. Nasc con BIOS 1.08 e successive.	H06188

PIASTRA BASE BA2155



- | | |
|---|--|
| 1 Connettore J4 porta seriale 2 (9 vie) | 12 Connettore J10 interfaccia mouse PS/2 |
| 2 Connettore J3 porta seriale 1 (9 vie) | 13 Connettore J7 interfaccia tastiera PS/2 |
| 3 Connettore J9 floppy disk | 14 Connettore J5 interfaccia parallela |
| 4 Connettore J6 video VGA | 15 Connettore J26 (non collegato) |
| 5 Connet. J1 dall'alimentatore SP300T-3 | 16 Connettore J16 (non collegato) |
| 6 Connet. J8 dall'alimentatore SP300T-3 | 17 Connettore J18 alla Swap Board |
| 7 Real Time Clock | 18 Connettore J22 ventola vano piastre |
| 8 EEPROM di configurazione | 19 Connettore J25 (non collegato) |
| 9 Slot piastra CPU | 20 Connettore J13 (non collegato) |
| 10 Slot PCI | 21 Connettore J21 (non collegato) |
| 11 Slot EISA | |

PONTICELLI

PONTICELLO		DESCRIZIONE
JP1	PIN 1-2 ON (DEF)	Il sistema viene predisposto secondo la configurazione di default e viene ignorata qualsiasi configurazione memorizzata nella EEPROM di configurazione e quindi tutte le prestazioni di sicurezza.
	PIN 2-3 ON (NORM) *	Posizione normale, all'accensione il sistema viene predisposto secondo la configurazione memorizzata nella EEPROM.

SEQUENZA PIASTRE NEGLI SLOT DELLA PIASTRA BASE

NOME PIASTRA	N.MAX PIASTRE	SLOT	BUS MASTER
BUS PCI			
Governo SCSI PCI (Dagger, Lance, DPT) primario	1	1	SI
Governo SCSI PCI (Dagger, Lance, DPT) aggiuntivo	3	1, 2, 3	SI
Governi linea con bus PCI	2	2, 3	SI
BUS EISA			
Governi linea con bus EISA (Stallion, ecc.)	4	3, 4, 5, 6, 7	SI
Governi linea con bus AT (ISA)	4	3, 4, 5, 6, 7	SI
BUS DEDICATO			
Piastra CPU	1	SLOT CPU	-

2

Note:

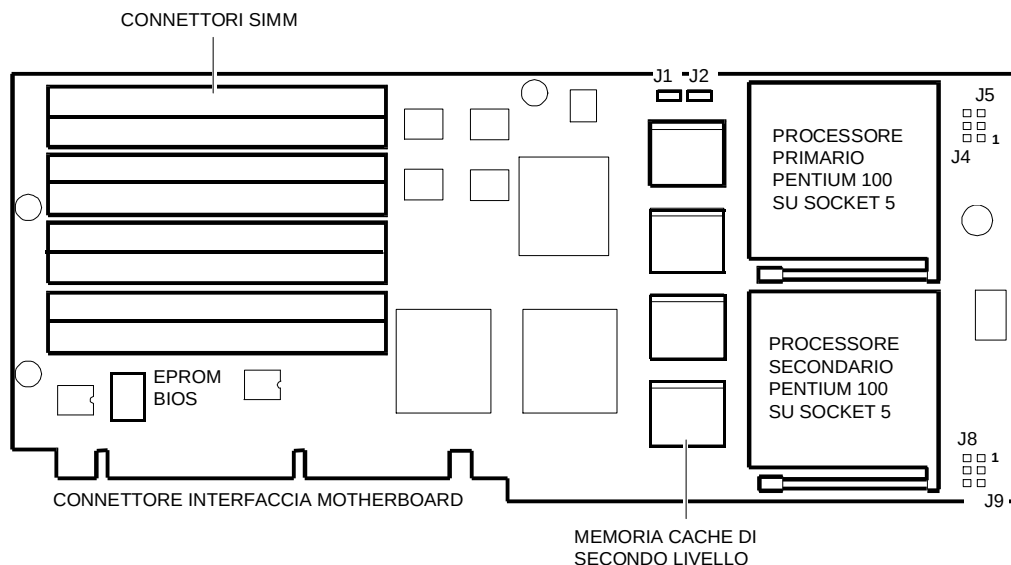
- *Lo slot 1 PCI è sempre occupato dal governo SCSI primario.*
- *Lo slot 3 è costituito fisicamente da 2 slot: 1 PCI ed 1 EISA. Questi due slot vengono però considerati logicamente come un unico slot condivisibile in quanto, essendo i due slot molto vicini fisicamente, è possibile inserire una sola piastra; se la piastra è PCI nello slot PCI (superiore), mentre se la piastra è EISA, ISA o ISA Plug and Play, nello slot EISA (inferiore).*
- *Negli slot liberi, sia PCI che EISA, non vi sono priorità da rispettare a meno che non si installino governi SCSI aggiuntivi, nel tal caso occorre che l'HDU di boot sia collegato al governo SCSI inserito nello slot prioritario (vedi paragrafo "Note di Configurazione Sistema in Presenza di più Governi SCSI").*

EVOLUZIONE PIASTRA BA2155 (Cod. c.s. 654305 K)

DATA	LIV.	COD. VIMO	MOTIVO MODIFICA	APPLIC.
01/95	Nasc	562156 Z	Introduzione piastra in sostituzione della BA904 per recupero filature.	Produz.
01/95	01		Mancato collegamento tra GND e Massa logica (zona video): eliminare 1 induttanza e 3 resistenze, sostituire una resistenza.	Produz.
04/95	02		Riduzione costi: eliminare 1 oscillatore, 15 resistenze, 1 RX/TX, 1 transistor, 1 capacità, 3 connettori (J25, J27, J2), 5 buffer, 1 LED.	Produz.
05/95	03		Sostituzione del componente Super I/O FDC37C665 step G con quello di nuova maschera FDC37C665 rev. A mask E.	Produz.
07/95	04		Il dispositivo Video Controller GD5422 non viene più prodotto dalla Cirrus Logic; sostituirlo con l'equivalente pin to pin e software compatibile GD5424.	Produz.
10/95	05		- Nell'intervallo di tempo nel quale il sistema viene spento e la stampante è ancora accesa (collegata in interfaccia parallela), si creano dei caratteri spuri che la stampante interpreta come validi, questo provoca delle stampe indesiderate o addirittura dei salti carta. La causa è stata individuata nel dimensionamento delle resistenze di pull-up di alcuni segnali dell'interfaccia in oggetto: sostituire le resistenze R186, R191, R192, R194 da 1 Kohm con resistenze da 4,7 Kohm. - Si è riscontrata una alta difettosità del componente video GD5422 su sistemi che usano il video DSM 40091. La causa è stata individuata nella non perfetta richiusura fra massa logica e GND del GD5422: collegare il pin 1 (catodo) del diodo D2 al pin 2 del condensatore C50, inserire 3 resistenze da 0 ohm nelle posizioni 267, 288, 302.	Produz.
1/96	01AG		Risoluzione perdita di configurazione della piastra DPT nei transistori di accensione/spegnimento in un sistema collegato a una stampante sempre accesa, in interfaccia parallela. La causa è stata individuata nel dimensionamento delle resistenze di pull-up di alcuni segnali dell'interfaccia in oggetto: sostituire le resistenze R187, R188, R189, R190, R193 da 1 Kohm con resistenze da 4,7 Kohm. La modifica in field è obbligatoria con retrofitting per Leed/Halifax (UK) ed al primo rientro per tutti gli altri sistemi. Causa indisponibilità della PAL del tipo 85C244-66 montata programmata in pos. U45 (GKWA), si utilizza in alternativa la GAL22V10 che programmata è WP64.	Produz.
1/96	02AG		Introduzione nuove maschere Step-B0 per i componenti ESC e PCEB: sostituire ESC (U26) da step A1/2 a step B0, N.F: GA0Y; sostituire PCEB (U39) da step A1/2 a step B0, N.F: GA0X. Sostituzione del componente RTC DS1287, in phase-out, con l'RTC alternativo DS1287A.	Produz.

DATA	LIV.	COD. VIMO	MOTIVO MODIFICA	APPLIC.
3/96	07	562156 Z	Risoluzione malfunzionamento delle piastre di rete TRICOM 3C592 - 3C597. Il sistema si bloccava dopo la configurazione della piastra a causa della generazione ritardata dei segnali AENx. Sostituire la PAL GWK5 pos. U23 con la PAL WP69 (nuovo programma); introdurre 4 filature: da U26 pin 120 a U23 pin 11, da U26 pin 119 a U23 pin 12, da U26 pin 118 a U23 pin 1, da U26 pin 117 a U23 pin 8; fare la tranciatura da U23 pin 8 ed il suo via.	Produz.

PIASTRA CPU GO2063 DUALPROCESSOR PER SNX 160/RS SYSTEMA 100 MHz



Note:

- Per il raffreddamento dei processori è sufficiente che sia montato sui chip un dissipatore di tipo passivo (senza ventolina), quindi i connettori J1 e J2, di collegamento delle ventoline dei dissipatori attivi, non sono usati.
- Eventuali SIMM aggiuntivi di espansione memoria vengono riconosciuti automaticamente attivando l'ECU o l'utility Setup del BIOS e quindi senza eseguire alcuna ponticellatura hardware.
- Opzionalmente è possibile sostituire il processore primario con futuri Overdrive Processor Intel.

PONTICELLI DI SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORI

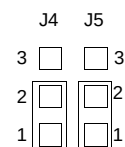
Questa piastra è predisposta per accettare processori del tipo a modalità VRE oppure a modalità Standard. Se funzionano con modalità VRE, i processori devono essere alimentati a +3,45 V, mentre se funzionano con modalità Standard devono essere alimentati a +3,3 V. Sulla piastra CPU sono presenti, per ognuno dei due processori, un circuito DC/DC converter ed un gruppo di ponticelli che permettono di selezionare la tensione di alimentazione di ogni processore e quindi la possibilità sulla stessa piastra di avere processori che funzionano con modalità differenti. La tensione +3,3 V proviene dall'alimentatore, mentre la tensione +3,45 V è ricavata, dal DC/DC converter, dalla tensione +5 V.

I processori Pentium 100 (primario o secondario) che operano con modalità VRE oppure Standard:

- Pentium 100 step B5 VRE (sigla sul chip 100 SX970)
- Pentium 100 step C2 VRE (sigla sul chip 100 SX962)
- Pentium 100 step C2 Standard (sigla sul chip 100 SX963)

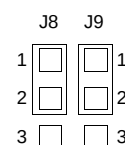
Questi processori vengono ponticellati sempre in modalità VRE in quanto anche lo step C2 tensione standard può funzionare nei limiti della tensione VRE ossia (3,135 V - 3,6 V). Gli Overdrive Processor attualmente in uso, invece, operano solo con modalità Standard. Quindi riassumendo la ponticellatura è la seguente:

SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORE PRIMARIO			
MODALITÀ	TIPO PROCESSORE	PONT. J4	PONT. J5
VRE (+3,45 V)	Tutti i tipi di Pentium 100	Pin 1-2	Pin 1-2
STD (+3,3 V)	Overdrive Processor	Pin 2-3	Pin 2-3



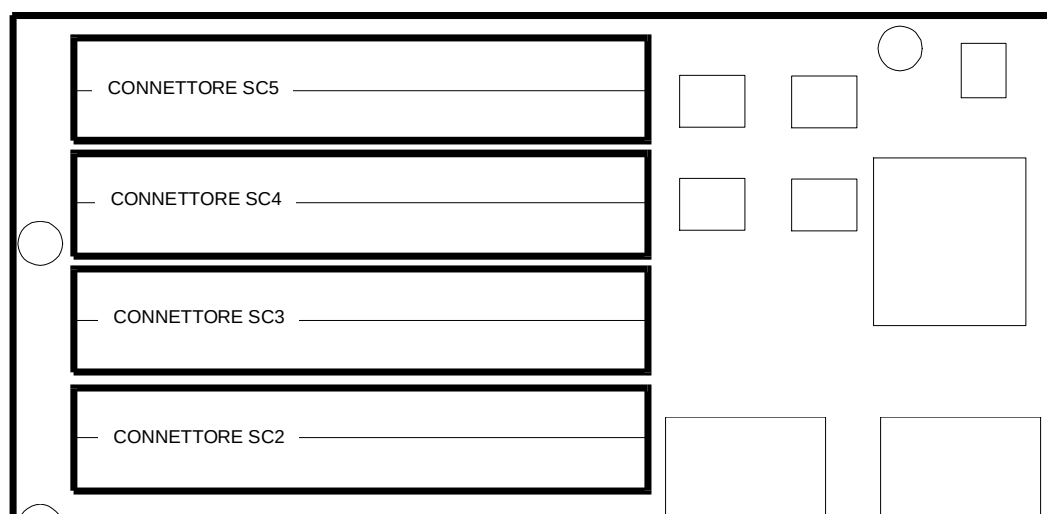
2

SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORE SECONDARIO			
MODALITÀ	TIPO PROCESSORE	PONT. J8	PONT. J9
VRE (+3,45 V)	Tutti i tipi di Pentium 100	Pin 1-2	Pin 1-2
STD (+3,3 V)	Non usato	Pin 2-3	Pin 2-3



Nota: Anche se il secondo processore non è montato, i ponticelli su J8 e J9 devono essere presenti e posizionati come su J4 e J5.

ESPANSIONE DI MEMORIA



Le regole di configurazione della memoria con SIMM parity e SIMM ECC sono:

- In genere, le configurazioni miste di SIMM parity e SIMM ECC sulla stessa piastra, anche se possibili, non sono consigliabili in quanto la protezione con ECC sui dati in memoria sarebbe solo parziale. Quindi si consigliano configurazioni solo con SIMM parity oppure solo con SIMM ECC.
- Il sistema vede la memoria suddivisa in 4 banchi (1, 2, 3 e 4). Ogni banco occupa quindi 2 connettori della piastra CPU. Banco 1: connettore doppio SC2, banco 2: connettore doppio SC3, banco 3: connettore doppio SC4, banco 4: connettore doppio SC5.
- I SIMM devono quindi essere sempre installati a coppie per riempire il banco di memoria. Ogni coppia è costituita da due SIMM che devono avere lo stesso tipo di densità e la stessa capacità.
- Sullo stesso sistema, ma non nello stesso banco di memoria, è possibile installare SIMM di diversa capacità.
- Installare i SIMM partendo sempre dal banco 1.
- I SIMM doppia faccia (DS) devono essere inseriti prima dei SIMM a singola faccia (SS), ossia devono essere inseriti nei banchi bassi (a partire dal banco 1). In caso di aggiunta di nuovi SIMM, occorre verificare che questa regola sia rispettata e, se necessario, spostare i SIMM SS nei banchi alti e quelli DS nei banchi bassi.

- Se il sistema è dotato di SIMM parity, la minima configurazione di memoria è di 16 MB, espandibile a 256 MB, mentre con SIMM ECC la minima configurazione di memoria è di 32 MB espandibili a 256 MB.

I moduli SIMM parity da utilizzare sono i seguenti:

NOME PDG	CAP	KIT ESPANSIONE MEMORIA
EXM 28-004	4 MB	1 SIMM SS 4 MB 70 ns (1 Mbit x 36). E necessario ordinare 2 kit
EXM 28-008	8 MB	1 SIMM DS 8 MB 70 ns (2 Mbit x 36). E necessario ordinare 2 kit
EXM 28-008/B	8 MB	1 SIMM DS 8 MB 70 ns (2 Mbit x 36) 1" H. E necessario ordinare 2 kit
EXM 28-016	16 MB	1 SIMM SS 16 MB 70 ns (4 Mbit x 36). E necessario ordinare 2 kit
EXM 29-032	32 MB	1 SIMM DS 32 MB 70 ns (8 Mbit x 36). E necessario ordinare 2 kit
EXM 40-032	32 MB	1 SIMM DS 32 MB 70 ns (8 Mbit x 36) 1" H. E necessario ordinare 2 kit

Nota: I SIMM con altezza 1" sostituiranno i SIMM con altezza standard.

La tabella seguente fornisce alcune combinazioni possibili di configurazione di memoria con SIMM parity.

MEMORIA TOTALE	BANCO 1		BANCO 2		BANCO 3		BANCO 4	
	CONNETTORI SC2		CONNETTORI SC3		CONNETTORI SC4		CONNETTORI SC5	
16 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB				
24 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB		
32 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
40 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB
56 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	16 MB	16 MB
88 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	32 MB	32 MB
24 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB				
40 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB		
56 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB
72 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB
104 MB	4 MB	4 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	32 MB	32 MB
40 MB	4 MB	4 MB	16 MB	16 MB				
72 MB	4 MB	4 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB		
104 MB	4 MB	4 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB
136 MB	4 MB	4 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB
72 MB	4 MB	4 MB	32 MB	32 MB				
136 MB	4 MB	4 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
200 MB	4 MB	4 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
16 MB	8 MB	8 MB						
32 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB				
48 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB		
64 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB
80 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB
112 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB	32 MB	32 MB
48 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB				
80 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB		
112 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB
144 MB	8 MB	8 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB

MEMORIA TOTALE	BANCO 1		BANCO 2		BANCO 3		BANCO 4	
	CONNETTORI SC2		CONNETTORI SC3		CONNETTORI SC4		CONNETTORI SC5	
80 MB	8 MB	8 MB	32 MB	32 MB				
144 MB	8 MB	8 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
208 MB	8 MB	8 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
32 MB	16 MB	16 MB						
64 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB				
96 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB		
128 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB
160 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB
96 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB				
160 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
224 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
64 MB	32 MB	32 MB						
128 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB				
192 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
256 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB

I moduli SIMM ECC da utilizzare sono i seguenti:

NOME PDG	CAPACITÀ	KIT ESPANSIONE MEMORIA
EXM ECC032	32 MB	2 SIMM ECC da 16 MB (4 Mbit x 36) 70 ns
EXM ECC064	64 MB	2 SIMM ECC da 32 MB (8 Mbit x 36) 70 ns

Nota: La nuova generazione di SIMM IBM con controllo ECC sono chiamati ECC-On-SIMM in quanto la funzione ECC è integrata sul SIMM stesso e fornisce la completa funzionalità di Single Error Correct (SEC) ed Error Correcting Code (ECC).

La tabella seguente fornisce alcune combinazioni possibili di configurazione di memoria con SIMM ECC.

MEMORIA TOTALE	BANCO 1		BANCO 2		BANCO 3		BANCO 4	
	CONNETTORI SC2		CONNETTORI SC3		CONNETTORI SC4		CONNETTORI SC5	
32 MB	16 MB	16 MB						
64 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB				
96 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB		
128 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB
160 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB
192 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
96 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB				
160 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
224 MB	16 MB	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
64 MB	32 MB	32 MB						
128 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB				
192 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB		
256 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB

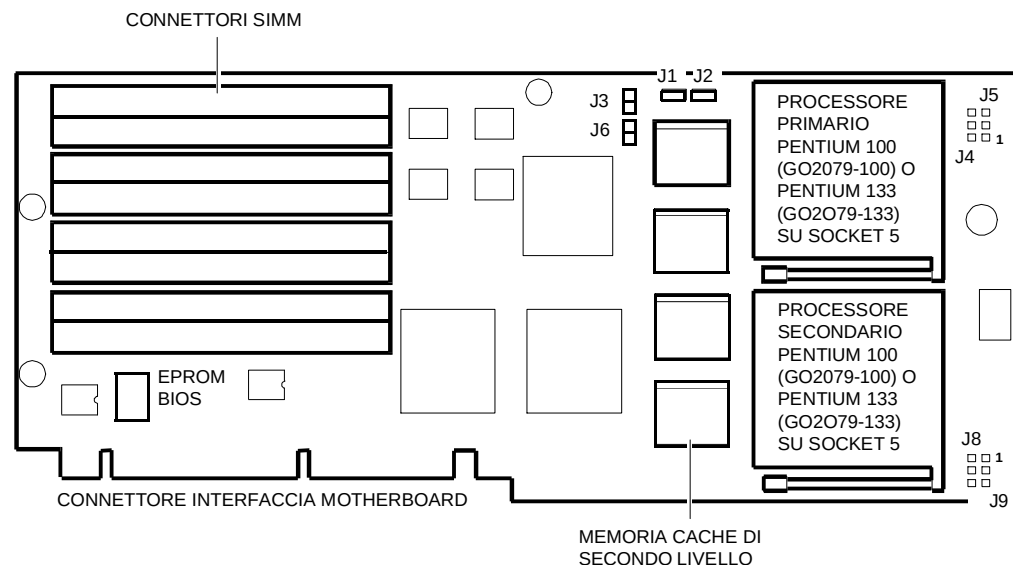
EVOLUZIONE PIASTRA GO2063 (Cod. c.s. 654348 V)

DATA	LIV.	COD. VIMO	MOTIVO MODIFICA	APPLIC.
5/95	Nasc	562262 B	Introduzione piastra. Il BIOS è compatibile per questa piastra è etichettato WE12. La prima release di BIOS è la 1.08 cod. 562382U liv Nasc. Le evoluzioni del BIOS sono descritte in seguito.	Produz.
9/95	01		Riduzione costi: sostituire i componenti in pos. U2, U3, U4, U5, U8, U9 da 74AC244 a 74F244; eliminare le resistenze R32, R33, R35, R61, R62, R63; eliminare il componente 74AC244 in pos. U13, eliminare il componente DS1620 (digital thermometer) montato in pos. TH1.	Produz.
12/95	02		Miglioramento dei margini funzionali della piastra, in previsione delle nuove maschere Intel sul processore P54C: sostituire 12 condensatori C26-C32-C33-C40-C59-C65 C182-C191-C194-C202-C218-C229 da 100 uF 6,3 V con 220 uF 10 V; sostituire il condensatore radiale C81 da 220 uF 10 V con 2200 uF 10 V.	Produz.

Nota: Da settembre 1995 viene sostituita la CPU P54C 66/100 MHz - step C2 - VRE (3,45-3,6 V) cod. 4893151U, con la CPU P54C 66/100 MHz - Step C2 - STD (3,1-3,6 V) cod. 4893113G.

PIASTRA CPU GO2079-100 DUALPROCESSOR (PER SNX 160/RS 100) GO2079-133 DUALPROCESSOR (PER SNX 160/RS 133 ED SNX 160/RS 133 W)

2



Note:

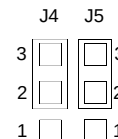
- Il nome della piastra GO2079 non cambia per la versione a 100 MHz e 133 MHz. Per comodità nel manuale, si differenziano le due versioni con le denominazioni GO2079-100 e GO2079-133.
- La piastra GO2079-100 a 66/100 MHz è identica alla GO2079-133 a 66/133 MHz tranne che per il tipo di processore montato (Pentium 100 o Pentium 133), e la disposizione dei ponticelli di selezione frequenza processori.
- Per il raffreddamento dei processori è sufficiente che sia montato sui chip un dissipatore di tipo passivo (senza ventolina), più alto di quello previsto per il processore Pentium 100, 25 mm invece di 16 mm. I connettori J1 e J2, di collegamento delle ventoline dei dissipatori attivi, non sono quindi usati.
- Eventuali SIMM aggiuntivi di espansione memoria vengono riconosciuti automaticamente attivando l'ECU o l'utility Setup del BIOS e quindi senza eseguire alcuna ponticellatura hardware.
- Opzionalmente è possibile sostituire il processore primario con futuri Overdrive Processor Intel.

PONTICELLI DI SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORI

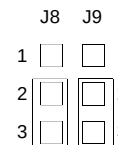
Questa piastra è predisposta per accettare processori del tipo a modalità VRE oppure a modalità Standard. Se funzionano con modalità VRE, i processori devono essere alimentati a +3,45 V, mentre se funzionano con modalità Standard devono essere alimentati a +3,3 V. Sulla piastra CPU sono presenti, per ognuno dei due processori, un circuito DC/DC converter ed un gruppo di ponticelli che permettono di selezionare la tensione di alimentazione di ogni processore e quindi la possibilità sulla stessa piastra di avere processori che funzionano con modalità differenti. La tensione +3,3 V proviene dall'alimentatore, mentre la tensione +3,45 V è ricavata, dal DC/DC converter, dalla tensione +5 V.

I processori Pentium 100 e Pentium 133 attualmente in uso operano con modalità standard e pertanto la ponticellatura è la seguente:

SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORE PRIMARIO			
MODALITÀ	TIPO PROCESSORE	PONT. J4	PONT. J5
VRE (+3,45 V)	Attualmente non usato	Pin 1-2	Pin 1-2
STD (+3,3 V)	Tutti i Pentium 100, Pentium 133 ed Overdrive Processor attuali	Pin 2-3	Pin 2-3



SELEZIONE TENSIONE ALIMENTAZIONE PROCESSORE SECONDARIO			
MODALITÀ	TIPO PROCESSORE	PONT. J8	PONT. J9
VRE (+3,45 V)	Non usato	Pin 1-2	Pin 1-2
STD (+3,3 V)	Tutti i tipi di Pentium 133 e Pentium 133	Pin 2-3	Pin 2-3



Nota: Anche se il secondo processore non è montato, i ponticelli su J8 e J9 devono essere presenti e posizionati come su J4 e J5.

Nota: Dal livello 01 della GO2079 sono stati eliminati i circuiti DC/DC converter per la selezione della tensione VRE dei processori in quanto i processori compatibili sono di tipo Standard. I relativi ponticelli di selezione rimangono e la loro posizione non cambia: J4, J5 e J8, J9 sui pin 2-3 (STD 3,3V).

PONTICELLI DI SELEZIONE FREQUENZA PROCESSORE

Su questa piastra inoltre vi è la possibilità di selezionare il rapporto della frequenza di clock tra il bus ed il "core" dei processori primario e secondario in 2/3, 1/2 e 2/5. Ciò consente quindi di impostare il clock dei processori e cioè di adattare la piastra al tipo di processore installato. La selezione si effettua tramite i due ponticelli a 2 pin J3 e J6.

PONT. J3	PONT. J6	RAPPORTO BUS/CORE	FREQUENZA PROCESSORI
IN	IN	2/5	166 MHz
OUT	IN	1/2	133 MHz (Per GO2079-133 - su SNX 160/RS 133, W MHz)
OUT	OUT	2/3	100 MHz (Per GO2079-100 - su SNX 160/RS 100 MHz)
IN	OUT	-	Riservato

Nota: È importante che questi ponticelli siano impostati correttamente perchè in caso contrario la velocità dei processori è diversa (es: il Pentium 133 con ponticelli impostati per 100 MHz, avrà una velocità di clock ridotta a 100 MHz, mentre impostando velocità più alte di quella del processore, si avrà un funzionamento fuori specifica. I ponticelli sono impostati in produzione e non devono essere cambiati. Il processore secondario deve essere uguale al primario, non sono ammesse configurazioni con processori a velocità differenti.

ESPANSIONE DI MEMORIA

I connettori per l'inserimento dei SIMM di memoria, la loro localizzazione, il tipo di SIMM supportati (standard ed ECC), le regole di configurazione della memoria e le tabelle con le possibili combinazioni, sono identiche a quelle viste per la piastra GO2063, pertanto, per queste informazioni, fare riferimento al relativo paragrafo.

Nota: I SIMM da 4 MB non vengono più prodotti.

EVOLUZIONE PIASTRA GO2079 (Cod. c.s. 654431 Z)

DATA	LIV.	COD. VIMO	MOTIVO MODIFICA	APPLIC.
1/96	Nasc	210710 K	Introduzione piastra CPU GO2079-133 con processore Pentium 133 a 133 MHz per SNX 160/RS 133 MHz. Inoltre questa piastra, con il processore processore Pentium 100 a 100 MHz, sostituisce la piastra GO2063 per miglioramento qualità di processo. La sostituzione della GO2063 viene effettuata ad esaurimento scorte. Il BIOS compatibile per questa piastra è etichettato WE12. La prima release di BIOS è la 2.02 cod. 562382 U liv. 02. Le evoluzioni del BIOS sono descritte in seguito.	Produz.
2/96	01		Eliminazione dei componenti del DC/DC converter che genera la tensione VRE per i processori. La piastra viene ponticellata solo in modo STD (3,3 V). I componenti da eliminare sono: TF9433 (U14-16), LTC1148 (U15), C120, C195, C49, L1, C147, C148, R68, R103, R60, R81, TF9410 (U21), L1431 (U18), C196, C88, C89, C146, D1, R71, R73, R101, R102, C81, C208, C230, C243, C256.	Produz.

2

EVOLUZIONE BIOS WE12 PER GO2063, GO2079

DATA	LIV.	BIOS	CODICE	MOTIVO MODIFICA
5/95	Nasc	1.08 WE12	562382 U	Introduzione BIOS WE12. Il BIOS è compatibile per SNX 140, 160, 140/R, 160/R, 160E, 160/RS. Si differenzia dalla release 1.07 (PZD5) per: - Supporto della piastra CPU 100 MHz. - Supporto completo di PCI ACFG versione 1.21U.
6/95	01AG	1.09 WE12		Sostituzione BIOS per: - Supporto del PNS5162, viene eliminato il serial test quando "Embedded special serial port" è abilitato.
1/96	02	2.02 WE12		Sostituzione BIOS per: - Supporto dei seguenti sistemi basati sul chip set Neptune: SNX 160 - 66/100 MHz, SNX 160 - 60/90 MHz, SNX 160 - 66/133 MHz, SNX 140 - 50/75 MHz. - Risoluzione malfunzionamento in NT 3.51 che segnala "PCI TARGET ABORT ERROR" al reboot dopo shutdown. Per i dispositivi PCI sono state invalidate le risorse di memoria agli indirizzi tra 0FFFC0000h e 0C0000000h e le risorse di I/O tra 0FFFFh e 0F000h. Ora gli indirizzi sono allocati sotto i 3 GB per il buffer e sotto 0EFFFh per le porte di I/O. - Risoluzione problema con OS2 e governi Dagger con spazio di I/O mappato a z805h. - Risolve problemi di configurazione con alcune piastre LAN.
4/96	03	2.03 WE12		Sostituzione BIOS per: - Abilitazione dello 0-Active RAS Mode quando la configurazione di memoria è realizzata con più di 4 SIMM; altrimenti lo 0-Active RAS Mode è disabilitato.

ELENCO SEGNALAZIONI E LIMITAZIONI

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

- Il pieno supporto per Configuration Manager e risoluzione di conflitti di risorse per piastre PCI ed ISA Plug and Play è disponibile dalla release 3.0 di ECU.
La versione di ECU prevista per questi sistemi è la 2.07 ed ha le seguenti limitazioni:
 - Durante il POD il BIOS configura le piastre PCI ed ISA Plug and Play, evitando conflitti con le risorse della motherboard e con le piastre ISA/EISA.
Il BIOS salva la configurazione delle piastre PCI/ISA Plug & Play nella NVRAM, come slot virtuali. Queste informazioni non possono però essere modificate in quanto vengono cancellate ogni volta che si utilizza il Configuratore o il ROM Setup per configurare il sistema e vengono riscritte nella NVRAM automaticamente dal BIOS durante il POD successivo. L'utente deve quindi assicurarsi che l'IRQ selezionato per lo slot virtuale dal configuratore coincida con quello selezionato per lo slot PCI fisico.
 - Quando si verifica un errore di configurazione al POD (corrupt NVRAM, invalid system configuration o ponticello bypass installato), non viene installato il driver Configuration Manager e viene visualizzato il codice di errore FFFFFFFFh. In queste condizioni è impossibile determinare la configurazione delle piastre PCI in quanto non vengono visualizzate le risorse ad esse assegnate. Per visualizzare con il Configuratore le risorse PCI assegnate occorre risolvere tutti gli errori nella NVRAM in modo che il driver CM possa essere installato correttamente. Si raccomanda quindi di attivare il programma System Configuration due volte: la prima per cancellare ogni errore dalla NVRAM, la seconda per visualizzare la configurazione completa PCI/EISA/ISA.
Questa procedura è raccomandata anche quando si inserisce o si rimuove una piastra PCI.
- Se una piastra Plug & Play viene rimossa dal sistema, le informazioni relative nella NVRAM non sono rimosse finché non viene caricato il driver Configuration Manager.
- Il codice nel BIOS che configura automaticamente le piastre PCI, non permette ad un dispositivo PCI di condividere un interrupt con un dispositivo EISA level-triggered, se vi è un altro interrupt disponibile. Solo se non vi è alcun interrupt disponibile, viene permessa la condivisione.
- Qualora l'utente decida di non utilizzare alcuni HDU presenti sul sistema estraendoli dal castelletto, deve rimuoverli completamente per evitare che le slitte degli HDU generino la perdita della prestazione di Hot Swap.
- I SIMM Double Side devono essere installati sulla piastra CPU partendo dai banchi più bassi.
- La prima versione di SNX 160/RS 133 W viene rilasciata solo in versione monoprocessor, per problemi del firmware F74 del governo DPT GO2098, evidenziati in fase di installazione di UnixWare 2.03 e SCO 3.2.4.2 in configurazione dualprocessor.

SERVER VIEW

- In ambiente NT i Power Net Agents non partono automaticamente. Se si desidera che partano automaticamente, occorre impostare l'attributo "automatic" come usual attraverso il Control Panel.

RESILIENCE SUPPORT

- Il package software OLIECC non è supportato da questo sistema. Quindi durante il caricamento del dischetto Resilience Support, in ambiente UnixWare 2.01, non procedere con la sua installazione.

2

SISTEMI OPERATIVI

- Effettuando il boot da floppy con S.O. UNIX AT&T, terminale remoto attivo e governo SVGA di motherboard abilitato, provoca hang di sistema. Questo è un problema del sistema operativo che al boot dà la precedenza al video controller anziché al terminale remoto sulla porta seriale.
- Per poter gestire in ambiente Unix SVR4 rel. 2.4.1 il CDR 4S-500 è necessaria la patch#5 V2.4.1.
- Con sistema operativo NetWare 3.12 e 4.1 non può essere usato il valore IRQ 15 per i governi RAID DPT Narrow e Wide.
- Con Windows NT 3.5 e solo con sistemi single-processor, dopo lo shutdown software occorre spegnere il sistema per il reboot. Per ovviare a questo problema si deve installare NT 3.5 con la procedura di setup "Custom" e scegliere l'opzione "Computer = Standard PC".
- Con i sistemi operativi Windows NT o Novell Netware (3.1x e 4.x), su sistemi con più di 64 MB di memoria, l'opzione "Extended Memory 16 MB Limit" deve essere abilitata (Enabled). Questa funzione può essere abilitata da Built-In ROM Setup o da configuratore.
- Con sistema operativo Windows NT 3.5, su sistemi con 32 MB di memoria, governo SCSI PCI RAID ed un alto carico di dischi, si possono verificare problemi con il DPT Engine. Occorre aumentare la memoria riservata di "NonPagedPool" nel registro WIN NT.

Il valore di default (0) del registro

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\NonPagedPoolSize

deve essere cambiato in 2097152 (2 MB)

- Con sistemi operativi UnixWare 2.0x con file system USF e Windows NT 3.5 e 3.51, in presenza di dischi di capacità superiore ad 1 GB, connessi al governo SCSI Dagger o Lance, occorre entrare con il configuratore alla voce "BIOS and Device Configuration" del governo SCSI e nel sottomenu "BIOS Configuration", impostare il parametro "Extended Translation for Drives > 1 GByte" come Disabled.
- Con sistema operativo SCO Unix 3.2.4.2 e il governo SCSI PCI RAID in configurazione RAID1, (mirroring), l'opzione "SCSI Cmd Queuing" dell'utility di configurazione della piastra, deve essere disabilitata. L'utility di configurazione può essere attivata al POD premendo CTRL-D. Questa limitazione sarà risolta dalla release di firmware del governo SCSI PCI RAID successiva alla 6CX.
- Con i sistemi operativi UnixWare e SCO Open Server 5.0 ed un carico di dischi elevato, può apparire il seguente messaggio:

```
INTERNAL ERROR M=3D T=3
MESSAGE TIMEOUT M=3D T=6
ERROR: returned from Engine, Program Terminated!
```

Occorre immediatamente rieseguire il processo di logging col seguente comando:
/usr/dpt/dptelog &.

- Con sistema operativo OS/2 2.11 e governo SCSI PCI RAID, il dischetto Supplemental, generato dallo Storage Manager, si installa nel modo seguente:
 - Aprire "OS/2 System Folder", quindi il "System Setup Folder".
 - Selezionare la voce "Device Driver Install".
 - Inserire il dischetto Supplemental nel drive.
 - Selezionare "Install". Al termine del comando, un messaggio ne riporta lo stato: viene visualizzato un errore se non viene trovato il governo.

Questa limitazione attualmente è stata risolta.

- Con sistema operativo SCO Open Server 5.0 non è possibile configurare insieme 2 governi Dagger perchè il driver riconosce un solo controller. Il secondo governo Dagger può essere aggiunto in seguito, dopo l'installazione monodagger.
- Con sistema operativo UnixWare 2.0x e utilizzando i governi RAID DPT Narrow o Wide connessi ad hard disk con capacità totale maggiore di 1 GB, si possono verificare dei problemi nella costruzione del file system UFS. Se accade ciò, utilizzare il file system VXFS.
- Con sistema operativo NetWare 3.12 e 4.1, usando workstation in connessione VLM (invece di NETX), con elevato stress del sottosistema di I/O (fase di ricostruzione RAID), può raramente accadere che una o più workstation vadano in hang. Se questo accade la workstation deve essere riinizializzata. Il problema scompare impostando adeguatamente la configurazione dei client quando si usa il modo di connessione VLM.
- Con sistema operativo Windows NT 3.51, possono apparire nell'Event Viewer, i messaggi ERROR 9 e/o ERROR 11. Questi errori non hanno effetto sulle operazioni del sistema e devono essere ignorati.
- Con sistema operativo Windows NT 3.51, dopo un logoff e successivo logon, occorre disattivare e riattivare la funzione DPTSRV.
- Con i sistemi operativi OS/2 2.11 o OS/2 3.0 (WARP), deve essere utilizzato il file system FAT invece di un HPFS.
- Per configurare il CD-ROM Sony CDU76S (4X) con sistema operativo OS/2 2.11 o OS/2 3.0 (WARP), selezionare:
SONY CDU 541,561,6211,7211,7811
nella finestra "CD ROM DEVICE SUPPORT".
- Con sistema operativo NetWare 3.12 o 4.1, durante il bootstrap, con CD-ROM connesso ad un governo SCSI RAID DPT PCI, può apparire il seguente messaggio che deve essere ignorato in quanto messaggio spurio:

WARNING: SCSI BIOS ROM Version is later than this driver version. Drive not installed.

Il CD-ROM funziona correttamente.

